

2024년 하계 교육 일정_4Day

날짜	0/00(월)	0/00(화)	0/00(수)	0/00(목)	-
장소	아진전자	아진전자	아진전자	아진전자	-
내용	패키징 이론	패키징 실습	패키징 실습	패키징 실습	-
09-12	후공정 패키징 개념이해 1. 컨벤셔널 패키징 아진전자 김성진대표	반도체용어 플라즈마 공정이해/실습 아진전자 김용식부장	플립칩본딩 공정이해/실습 (Cu Piller) (Au Bump) 아진전자 김용식부장	FCBGA 공정이해/실습 아진전자 김용식부장	-
12-13	점심시간				
13-14	후공정 패키징 개념이해	웨이퍼마운트 공정이해/실습	플립칩본딩 공정실습 Cu Piller Au Bump	단면분석실습 (Cross section) 아진전자 김용식부장	-
14-15			언더필 공정이해/실습 아진전자 김용식부장		
15-16	2. 어드밴스드 패키징	다이싱 공정이해	Cross Section 이해 (몰딩실습)		
16-18	아진전자 김성진대표	아진전자 김용식부장			

2024년 하계 세부 강연 일정_4Day

일정		주제	교육내용	강연자
0/00 (월)	09:00~12:00	3h	반도체 이론 (이론) 반도체 패키징 Conventional Package	김성진 대표 박지우 과장 아진전자
	12:00~13:00		중식	
	13:00~16:00	3h	반도체 이론 (이론) 반도체 패키징 Advanced Package	김성진 대표 박지우 과장 아진전자
	16:00~18:00	2h	반도체 이론 (이론) 반도체 용어	김성진 대표 박지우 과장 아진전자
0/00 (화)	09:00~12:00	3h	패키징 공정 (이론) 플라즈마 장비 및 공정 이해 (실습) 플라즈마 공정 실습	김용식 부장 박지우 과장 아진전자
	12:00~13:00		중식	
	13:00~14:00	1h	패키징 공정 (이론1) 웨이퍼마운트 장비 및 공정 이해 (이론2) UV 조사기 장비 및 공정 이해	김용식 부장 박지우 과장 아진전자
	14:00~15:00	1h	패키징 공정 (실습1) 웨이퍼마운트 공정 실습 (실습2) UV 조사기 공정 실습	김용식 부장 박지우 과장 아진전자
	15:00~18:00	3h	패키징 공정 (이론3) 다이싱 장비 및 공정 이해 (실습3) 실리콘 웨이퍼 다이싱 실습	김용식 부장 박지우 과장 아진전자
0/00 (수)	09:00~12:00	3h	패키징 공정 (이론) 플립칩 본딩 장비 및 공정 이해 (실습1) 플립칩 본딩 공정 실습 (Cu pillar)	김용식 부장 박지우 과장 아진전자
	12:00~13:00		중식	
	13:00~14:00 14:00~15:00	2h	패키징 공정 (실습2) 플립칩 본딩 공정 실습 (Au bump)	김용식 부장 박지우 과장 아진전자
	15:00~17:00	2h	패키징 공정 (이론) 언더필 장비 및 공정 이해 (실습) 언더필 공정 실습	김용식 부장 박지우 과장 아진전자
	17:00~18:00	1h	패키징 공정 (이론) Cross Section 공정 이해(단면분석) (실습) Cross Section 몰딩 실습	김용식 부장 박지우 과장 아진전자
0/00 (목)	09:00~10:00	1h	패키징 공정 (이론) FCBGA 공정 이해	김용식 부장 박지우 과장 아진전자
	10:00~12:00	2h	패키징 공정 (실습) FCBGA 공정 실습	김용식 부장 박지우 과장 아진전자
	12:00~13:00		중식	
	13:00~17:00	4h	패키징 공정 (실습) 크로스 섹션 공정 실습	김용식 부장 박지우 과장 아진전자
	17:00~18:00	1h	패키징 공정 설문조사 및 수료식	아진전자